

# DRAMチップの TEM・SEMによる構造解析

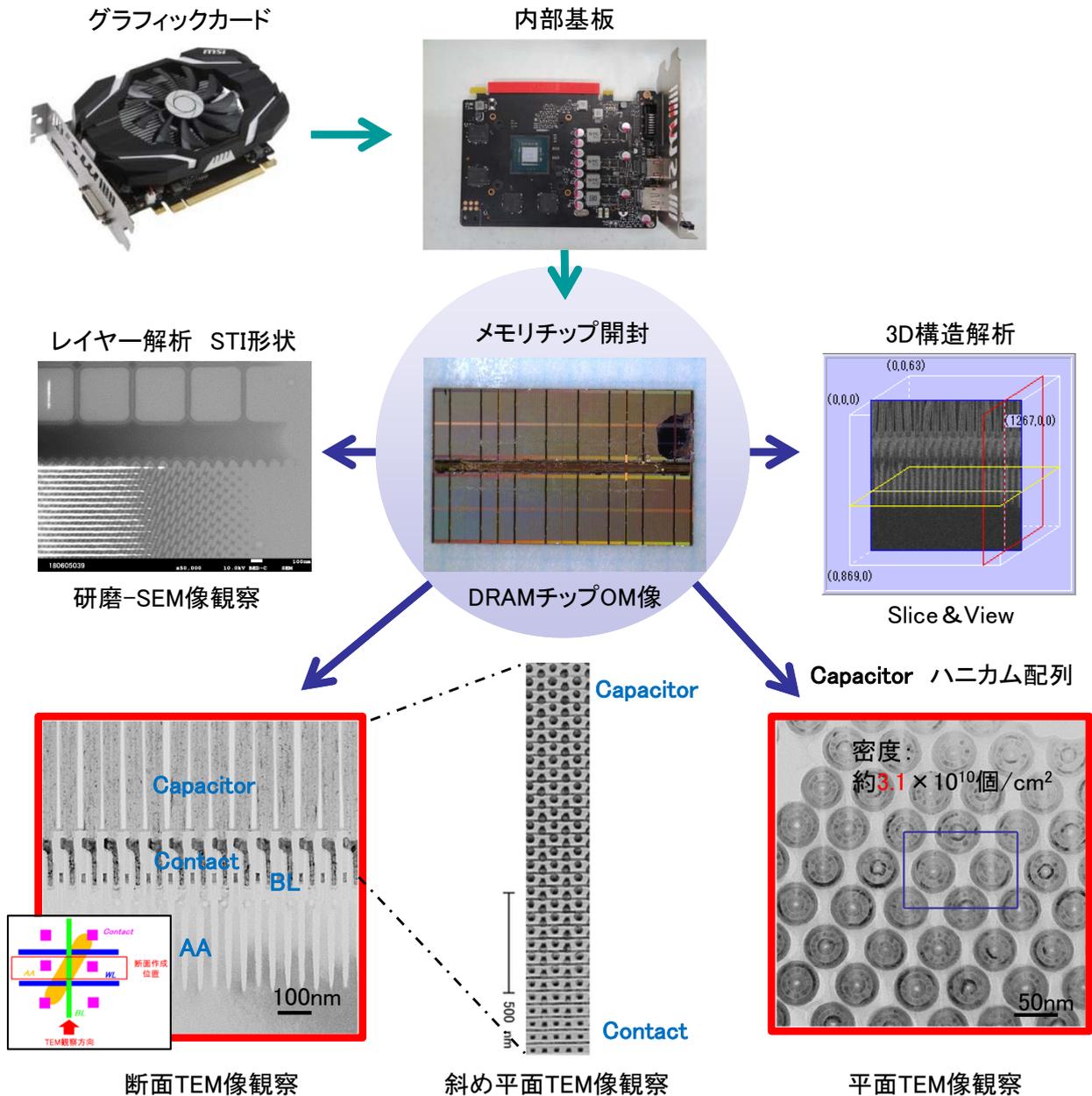
## 製品内基板上DRAMのリバースエンジニアリング

測定法 : TEM・SEM  
製品分野 : LSI・メモリ  
分析目的 : 形状評価・構造評価・製品調査

### 概要

代表的なメモリであるDRAMについて製品レベルからTEM観察による素子微細構造解析まで一貫して分析します。  
外観観察からレイヤー解析、Slice & Viewを行うことで構造の全体像を把握し、FIB加工位置をナノレベルで制御し薄片形成後にメモリ部の微細構造をTEM像観察しました。

### データ



分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！